

Profile & History



会社概要

- 会社名 株式会社サンテック
- 所在地 本社・工場
〒190-1232
東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-1-10
TEL. 042-557-7744
FAX. 042-557-7745
- 代表者 代表取締役 日野 榮
- 創業 平成9年3月
- 資本金 1000万円
- 業務内容 半導体他ダイシング加工
- 従業員数 47名 (平成22年7月現在)
- 取引銀行 多摩信用金庫・西武信用金庫
青梅信用金庫・りそな銀行

会社沿革

- 平成 9年 3月 サンテック有限会社として創業開始。
(工場所在地 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原16-10)
- 平成 9年 3月 LEDチップ基盤のダイシング加工を開始。
- 平成 9年 5月 超薄型(50ミクロン)ウエハダイシング加工試作ライン立上げ。
- 平成 9年 9月 大手半導体メーカー液晶用ドライバーのダイシング加工量産開始。
- 平成12年 4月 本社・工場を箱根ヶ崎東松原21-2へ移転。
- 平成13年 1月 株式会社サンテックへ組織変更。
- 平成14年 7月 大手半導体メーカーより工場認定を取得。
- 平成14年10月 ISO9001・2000認証取得。
- 平成15年 4月 バックグラインダー工程立上げ。
- 平成15年 6月 特殊ガラスダイシング加工開始。
- 平成15年12月 工場増設(クリーンルーム拡張 304m²)。
- 平成16年11月 ISO14001認証取得。
- 平成18年 8月 新社屋完成 本社・工場を移転。
(工場所在地 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-1-10)
- 平成19年 6月 12インチウエハダイシング加工ライン整備
- 平成19年 8月 ポリッシング工程立上げ (60μm量産)
- 平成21年 7月 ブルーガラスダイシング加工量産開始

工場概要

- 土地面積 1000m²
- 延床面積 900m²
- クリーンルーム 550m²
- クラス 500ヶ(0.5μm) (一部100ヶ以下)

株式会社サンテック組織表

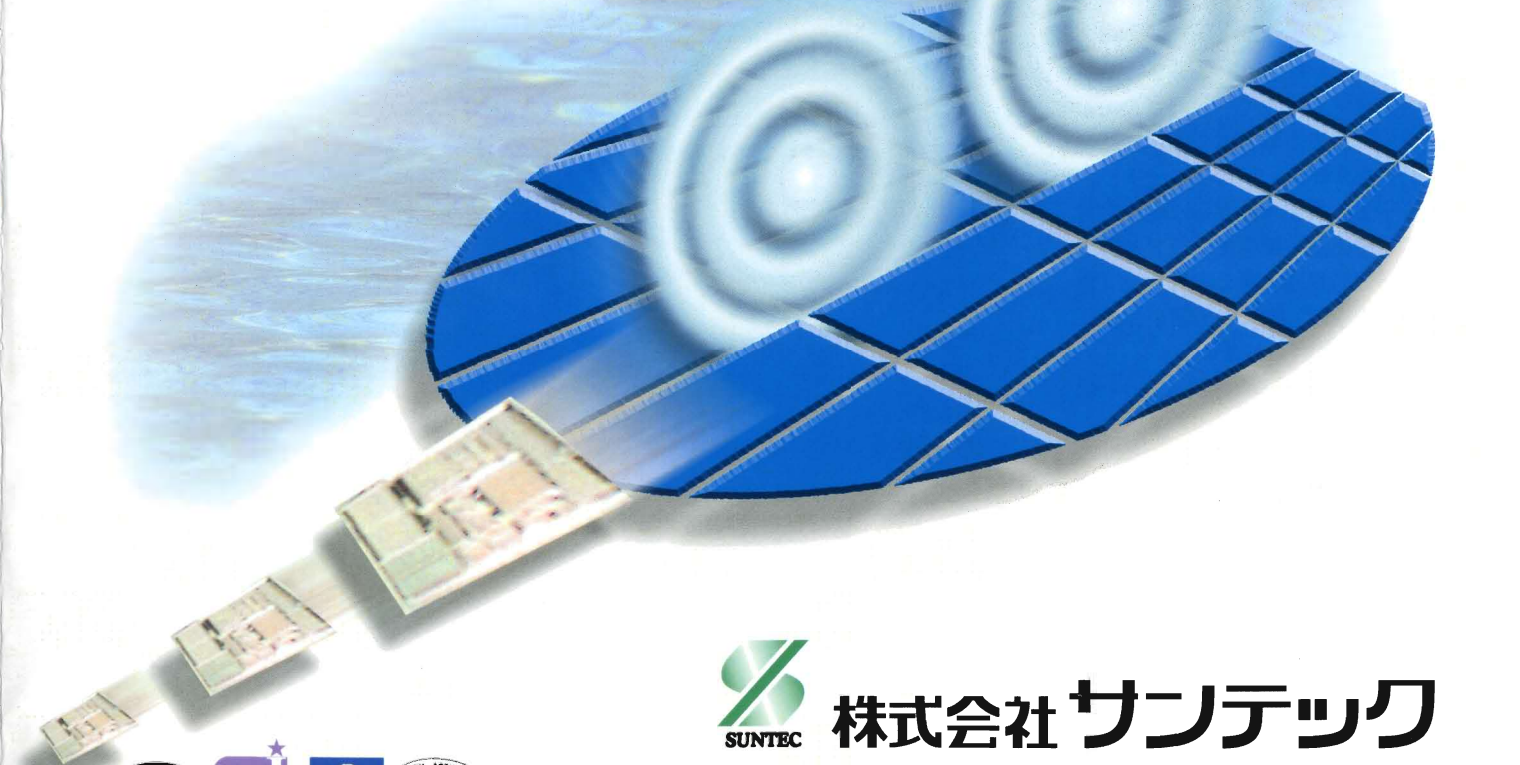


SUNTEC 株式会社 サンテック

〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-1-10
TEL 042-557-7744 (代)
FAX 042-557-7745
E-mail : suntec@c-suntec.co.jp
URL : <http://www.c-suntec.co.jp>

Company Profile

会社案内



SUNTEC 株式会社 サンテック

URL <http://www.c-suntec.co.jp>



ISO 9001

ISO 14001

試作開発～量産まで 高品質と納期を最重要視している会社です。

サンテックはダイシング加工のパイオニアとして 半導体、他 微細加工技術のお手伝いを致します。

【特殊加工】
大型基板ダイシング可能
(300mm、3mm厚まで対応)

《12インチウェハのダイシング加工ができます。》



ご挨拶

当社は創業以来、半導体加工における技術集団として、お客様からの厚いご支援を戴きながら、共に半導体産業を担う一員として一歩一歩あゆんでまいりました。「ダイシング」という加工技術が世の中に誕生した当初より装置メーカー様と連携をとり微細加工技術を研鑽してまいりました。

ダイシング加工における技術の提供はもとより、Q(品質)・C(コスト)・D(納期)・S(サービス)を追求しお客様への満足をお届けしております。

大手半導体メーカー各社・ベンチャー企業他、幅広い分野の皆様のお手伝いをさせて戴いております。

社員一人一人の個性を伸ばし、その力を十分発揮できる環境を与え、「ダイシング加工における最高品質の実現」と「環境に配慮した企業活動」を目指し、全社員一丸となって邁進致します。

代表取締役 日野 榮

経営理念

- 一. 『お客様の信頼と満足を第一』とすること。
- 二. 取引の基本は『Face to Face』お客様との対話に時間を惜しまないこと。
- 三. 現場・現物主義を貫くこと。
- 四. 社員は会社の財産、人材育成と教育に労を惜しまないこと。

B/G工程 「バックグラインド」 「ポリッシング」

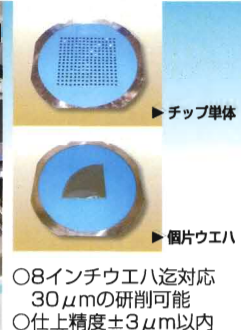
- リング固定方式により搬送時の割れを軽減。
- 粗/仕上げ研削を分けることで、高精度の研削を行います。
- チップ単体及び個片ウエハの研削も行います。



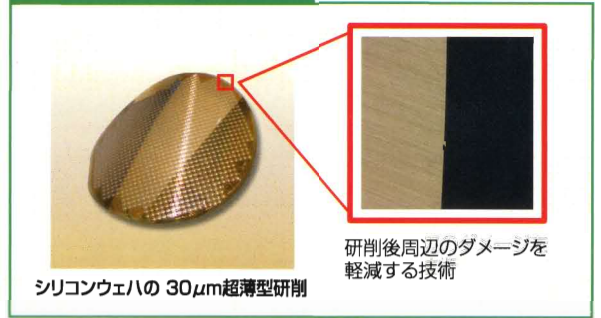
バックグラインダー



ポリッシング装置



シリコンウェハ

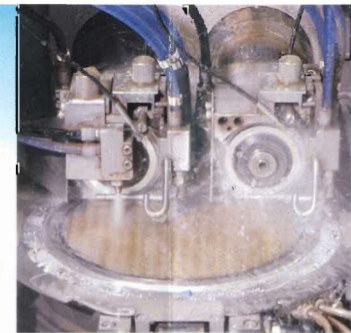


ダイシング工程 「切断」

- 半導体シリコンの微細加工ほか、セラミック・光学ガラス・ガラス基板・特殊素材(貼り合せ)のダイシング加工を行います。

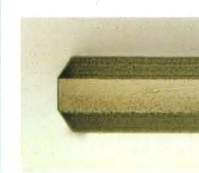


ダイシング

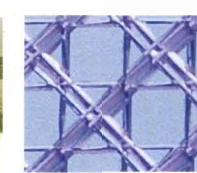


特殊加工

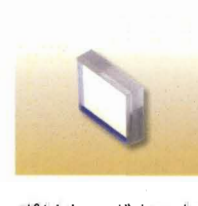
ガラス



ガラス



特殊素材



チップソート工程 「選別整列」

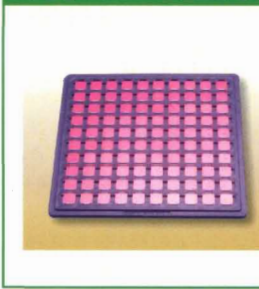
- マップ方式による分類対応(最大24分類可能)
- 超薄型チップ、長尺チップ、微小チップのトレー詰、光学ガラス他特殊素材のトレー詰を行います。



チップ選別/分類



光学ガラスの整列



微細チップの整列



外観検査工程

金属顕微鏡及び、実体顕微鏡
X25倍～X500倍率検査。



外観検査 ○金属顕微鏡による全数検査



出荷検査 ○抜き取りによる最終検査



払出・梱包 ○ラベル検査から出荷機



クリーンルーム内(天井へパフィルター)
○ピンポイントでクラス100可能